



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号： PCN#20120310001
2012 年 3 月 13 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL-SLL DBV/DCKパッケージ LVC LL製品 チップ一部改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	<input checked="" type="checkbox"/> Design/Specification	<input checked="" type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HVAL-SLL DBV/DCKパッケージ LVC LL製品 チップ一部改定 現行 : チップレビジョン Rev - 変更後 : チップレビジョン Rev G			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	6月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容 : 弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) DBV/DCKパッケージ LVC LL製品について、供給能力確保の為に、チップレビジョンを現行 Rev “-” からRev G にチップを一部改定します。データシート規格値に変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容 現行 変更後
 チップレビジョン Revision - Revision G

理由 : 供給能力確保の為

詳細 :

本変更は、現行製品と同一の成熟技術プロセスを使用したチップの最適化で、供給能力向上に貢献します。チップ改定品は、同一の品質性能を有し、データシート規格値及び製品名に変更はありません。

対象製品リスト

対象製品名				
SN74LVC1G57DBVR	SN74LVC1G58DBVRG4	SN74LVC1G97DBVTE4	SN74LVC1G97DCKTE4	SN74LVC1G98DCKR
SN74LVC1G57DBVRE4	SN74LVC1G58DCKR	SN74LVC1G97DBVTG4	SN74LVC1G97DCKTG4	SN74LVC1G98DCKRE4
SN74LVC1G57DBVRG4	SN74LVC1G58DCKRE4	SN74LVC1G97DCK3	SN74LVC1G98DBVR	SN74LVC1G98DCKRG4
SN74LVC1G57DCKR	SN74LVC1G58DCKRG4	SN74LVC1G97DCK6	SN74LVC1G98DBVRE4	SN74LVC1G98DCKT
SN74LVC1G57DCKRE4	SN74LVC1G97DBVR	SN74LVC1G97DCKR	SN74LVC1G98DBVRG4	SN74LVC1G98DCKTE4
SN74LVC1G57DCKRG4	SN74LVC1G97DBVRE4	SN74LVC1G97DCKRE4	SN74LVC1G98DBVT	SN74LVC1G98DCKTG4
SN74LVC1G58DBVR	SN74LVC1G97DBVRG4	SN74LVC1G97DCKRG4	SN74LVC1G98DBVTE4	
SN74LVC1G58DBVRE4	SN74LVC1G97DBVT	SN74LVC1G97DCKT	SN74LVC1G98DBVTG4	

製品表示

この変更に伴い、チップレビジョン、出荷ラベル記載のチップレビジョンが下記のように変更されます。

	チップレビジョン (2P)
現行	"_"
変更後	G



図1 出荷ラベル記載箇所の例

信頼性試験

信頼性試験結果						
信頼性試験期間	開始				終了	2012年2月3日
信頼性試験 - 試料構成詳細						
ID:	Device1	Device2	Device3	Device4		
Qual Device:	SN74LVC1G57DCKR	SN74LVC1G58DCKR	SN74LVC1G97DCKR	SN74LVC1G98DCKR		
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB		
Wafer Process:	50b10.13_BOPO2	50b10.13_BOPO2	50b10.13_BOPO2	50b10.13_BOPO2		
Wafer Size:	200 mm Dia.	200 mm Dia.	200 mm Dia.	200 mm Dia.		
Metallization:	Ti300/TiN1700/AlCu0.5=6000/TiN500					
信頼性試験結果						
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails				
		Device1	Device2	Device3	Device4	
Electrical Char - LV	per spec	Approved	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability -TQ	Approved by A-T Site	Approved	Approved	Approved	Approved	
X-Ray	Bottom-side Only	-	5/0	-	-	

信頼性試験結果						
信頼性試験期間	開始				終了	2012年1月27日
信頼性試験 - 試料構成詳細						
ID:	Device1	Device2	Device3	Device4		
Qual Device:	SN74LVC1G57DBVR	SN74LVC1G58DBVR	SN74LVC1G97DBVR	SN74LVC1G98DBVR		
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB		
Wafer Process:	50b10.13_BOPO2	50b10.13_BOPO2	50b10.13_BOPO2	50b10.13_BOPO2		
Wafer Size:	200 mm Dia.	200 mm Dia.	200 mm Dia.	200 mm Dia.		
Metallization:	Ti300/TiN1700/AlCu0.5=6000/TiN500					
信頼性試験結果						
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails				
		Device1	Device2	Device3	Device4	
Manufacturability-TQ	Approved by A-T Site	Approved	Approved	Approved	Approved	
Electrical Char	per spec	Approved	Approved	Approved	Approved	
Latch-up	Per JESD78, Class II	6/0	-	6/0	6/0	
X-RAY	Bottom Side Only	-	5/0	-	-	
Life Test	150C, 300 Hrs.	-	77/0	-	-	
ESD MM	150V	3/0	-	3/0	3/0	
ESD MM	200V	-	3/0	-	-	
ESD CDM	1000V	3/0	3/0	3/0	3/0	
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0	3/0	